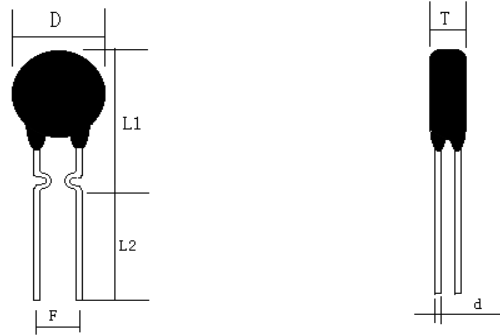


1、一般参数 (Common Parameters) :

(1) 尺寸 (mm) (Size)



DMax	L1Max	L2Min	F	TMax	d
7.5	14.0	20	5.0±1.0	3.5	0.6±0.03

(2) 材料 (Materials)

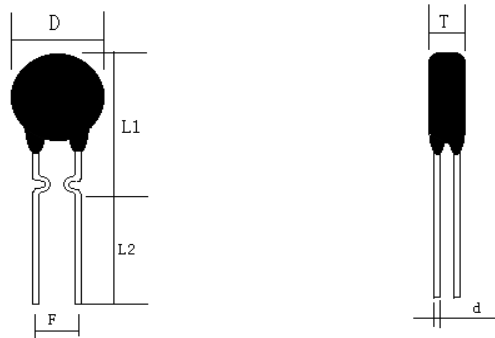
- ①封装材料 (Wrapper) : 聚硅树脂 (Phenolic resin)
- ②引线 (Down-lead) : 镀锡电子线 (Tinned Electron Wire)
- ③颜色 (Coating color) : 黑色 (Black)

2、主要技术参数 (Parameters of Technology) :

- ①25℃时零功率电阻值 (Ω) (Zero Power Resistance at 25℃) : 10±20%
- ②B 值 25/50℃ (K) (B Value) : 2700
- ③热时间常数(S) (Thermal Time Constant) : 28
- ④热耗散系数 (mW/℃) (Thermal Dissipation Constant) : 9
- ⑤工作温度 (℃) (Operating Temperature) : -40 - +180
- ⑥最大稳态电流 (Imax/25℃) (Max Steady State Current) : 1
- ⑦最大冲击电容量(μF/240V) (Max. Shock Capacity) : 100

1、一般参数 (Common Parameters) :

(1) 尺寸 (mm) (Size)



DMax	L1Max	L2 Min	F	TMax	d
11	20.0	20	7.5 ± 1.0	3.8	0.75 ± 0.03

(2) 材料 (Materials)

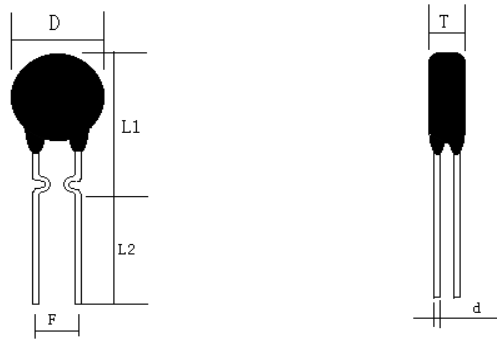
- ①封装材料 (Wrapper) : 聚硅树脂 (Polysilicon resin)
- ②引线 (Down-lead) : 镀锡电子线 (Tinned Electron Wire)
- ③颜色 (Coating color) : 黑色 (Black)

2、主要技术参数 (Parameters of Technology) :

- ①25℃时零功率电阻值 (Ω) (Zero Power Resistance at 25℃) : 10 ± 20%
- ②B 值 25/50℃ (K) (B Value) : 2800
- ③热时间常数(S) (Thermal Time Constant) : 45
- ④热耗散系数 (mW/℃) (Thermal Dissipation Constant) : 17
- ⑤工作温度(℃)(Operating Temperature) : -40 - +180
- ⑥最大稳态电流(I_{max}/25℃) (Max Steady State Curren : 3
- ⑦最大冲击电容量(μ F/240V) (Max. Shock Capacity) : 330

1、一般参数 (Common Parameters) :

(1) 尺寸 (mm) (Size)



DMax	L1Max	L2 Min	F	TMax	d
13.5	21.0	20	7.5±1.0	4.5	0.75±0.03

(2) 材料 (Materials)

- ①封装材料 (Wrapper) : 聚硅树脂 (Phenolic resin)
- ②引线 (Down-lead) : 镀锡电子线 (Tinned Electron Wire)
- ③颜色 (Coating color) : 黑色 (Black)

2、主要技术参数 (Parameters of Technology) :

- ①25℃时零功率电阻值 (Ω) (Zero Power Resistance at 25℃) : 5 ± 20%
- ②B 值 25/50℃ (K) (B Value) : 2800
- ③热时间常数(S) (Thermal Time Constant) : 64
- ④热耗散系数 (mW/℃) (Thermal Dissipation Constant) : 19
- ⑤工作温度(℃)(Operating Temperature) : -40-+180
- ⑥最大稳态电流(I_{max}/25℃) (Max Steady State Current) : 5
- ⑦最大冲击电容量(μ F/240V) (Max. Shock Capacity) : 570